

BGA返修台 DIC

产品名称	BGA返修台 DIC
公司名称	苏州鹏健电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:DIC 型号:RD-500III/SIII、RD-500V/SV
公司地址	苏州市吴中区木渎镇藏书永丰村1组
联系电话	0512-66051125 13814886978

产品详情

日本dic返修台 rd-500 (iii) 品牌日本dic 型号 rd-500ii 温度调节范围 0-650 () 温度稳定度 ± 1 () 输入电压 220 (v) 发货期限 30天内发货 最大功率 3800 (w) 外形尺寸 770wx770dx760h (mm) 重量 78 (kg) 产品说明 1.独特的三部分发热体设计 rd-500 ii 可从元器件顶部及pcb底部同时进行热风微循环局部加热,再辅以大面积暗红外线区域加热,能完全避免在返修过程中的pcb翘曲.通过软件自由选择同时或单独使用上部或下部发热体,并自由组合上下发热体能量,使得对无铅socket775、双层bga等器件的返修变得简单。2.auto-profiling功能自动生成加热曲线 使用rd-500 ii软件自带的auto-profiling功能,将非常容易地自动生成任何理想的加热曲线。rd-500ii同时监控返修元器件焊点与表面温度,并根据二者温差自动进行上下发热体热量调整与温度补偿,可完全避免在返修过程中的元器件过热损坏。3.卓越的光学对中系统 rd-500 ii的光学对中是由ccd摄像系统自动获取pcb及器件焊点影像,通过微调让两者完全重合而实现.图像最大放大倍数为元器件的126倍;对于特别大的元器件,软件具有屏幕分割功能,用于放大检查元器件的两个对角。4.自动化程度高,完全避免人为作业误差 rd-500ii可自动识别拆和装的不同流程。在拆除元器件的流程中,加热完成后机器自动将元器件与pcb分离,可避免由于人为作业滞后于机器加热而导致元器件冷却无法拆除;在装元器件的流程中,对中完成后,机器将自动完成放置,加热,冷却的全部过程,避免手工贴装的移位,返修良品率可达100%。

本产品的加工定制是否,品牌是DIC,型号是RD-500III/SIII、RD-500V/SV,用途是BGA拆、焊维修,别名是BGA拆焊台、REWORK,规格是500*600MM,技术参数是功率3800W、返修PCB尺寸500*600